

REVENDEICATIONS

1. Module à puce de circuit intégré (1C), comprenant :
- un substrat isolant (3),
 - 5 - des métallisations comprenant pistes conductrices (25), réalisées d'un même côté du substrat (12), formant une antenne (2) et comportant deux extrémités de connexion (8, 9),
 - une zone d'enrobage (16) ou d'emplacement de la puce de circuit intégré radiofréquence (4) et d'un composant (14) sous
 - 10 forme de composant monté en surface (SMD),
 - la puce de circuit intégré radiofréquence et le composant étant disposés sur une même face du substrat et connectés à l'antenne (2), par une connexion électrique, caractérisé en ce que les métallisations (2) sont d'un seul
 - 15 même côté du substrat isolant, ladite connexion électrique (28, 26 s'effectuant par le biais de perforations (17) à travers le film isolant (3) ou directement sur des métallisations en surface.
- 20 2. Module selon la revendication précédente, caractérisé en ce qu'il comprend une spirale comportant des spires d'antenne (25) en périphérie (33) du substrat, la puce (4) et le composant (14) étant disposés à l'intérieur de la spirale.
- 25 3. Module selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comprend une borne métallisée de redirection (21) à l'intérieur de la spirale, ladite borne métallisée de redirection étant reliée à l'antenne (2) par une liaison électrique (19) à l'état sectionné ou décourt-
- 30 circuité.
4. Module selon la revendication précédente, caractérisé en ce que ledit état sectionné ou décourt-circuité résulte d'une opération parmi une ablation mécanique ou laser, une
- 35 perforation ponctuelle (18) du film support et de ladite liaison, une abrasion mécanique, un poinçonnage.

5. Module selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la puce (4) et le composant (14) sont connectés à une même paire de bornes d'interconnexion (8,21) disposée à l'intérieur de la spirale.

5

6. Module selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comporte une borne externe de l'antenne (9) ramenée à proximité de la métallisation d'interconnexion (21) par l'intermédiaire d'une déviation (D) des spires, ladite déviation (D) s'étendant de la périphérie du film support vers l'intérieur de la spirale et ladite borne métallisée d'interconnexion (21).

10

7. Module selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé en que le composant (14) est une capacité.

15

8. Module selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en que le composant (14) présente une surface disposée en regard du substrat isolant inférieure à celle que présente une surface de la puce de circuit intégré radiofréquence disposée en regard du substrat isolant.

20

9. Module selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en que le composant (14) et la puce de circuit intégré radiofréquence sont enrobés d'une même matière d'enrobage (6).

25

10. Dispositif (23, 30) tel qu'une carte à puce comportant le module (1A, 1B) selon l'une des revendications précédentes.

30

11. Dispositif selon la revendication précédente, caractérisé en ce qu'il comprend un corps (22) avec une cavité (C1, C2) débouchant en surface et ledit module (1A, 1B) encarté et fixé dans la cavité.

35